



BGA900D 紅外線BGA返修設備

特點

● 全紅外線燈管發熱系統

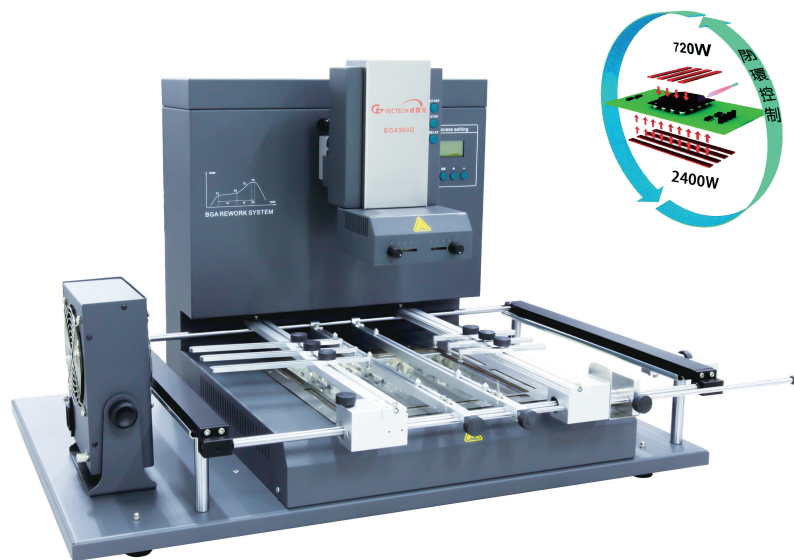
全機採用 IR 紅外線燈管 (波長約 2~8 μ) 2400W 大功率輸出，能快速到達 PCB 板底部大面積的預熱。同時配置特殊的 PCB 板夾具及底部支撐架，可避免 PCB 板變形板翹。全機具有溫度失控及輸入電壓壓降不穩定，自動切斷發熱器加熱電源，具有雙重超溫保護裝置。

● BGA 元件迴焊關鍵視覺

上部 IR 紅外線燈管加熱器可調整加熱光圈視窗系統，可保護 PCB 板上加熱區域，四周佈局的零件對溫度敏感的熱源防護，不需更換零件尺寸的熱風頭。紅外線無風加熱，不受作業環境及冷機、熱機的溫差影響。採取『開放式目視環境』，可目視 清楚觀察到 BGA 元件的錫球熔錫、助焊劑活化、零件塌陷、錫球和銅箔焊點共晶形成的完整過程，為其整個元件迴焊過中錫球熔錫的溫度精確判斷，提供了關鍵性的視覺訊息，拆焊 BGA 元件良率可達到 99%以上。

● 紅外線偵測 BGA 元件溫度

採用 IR 紅外線燈管溫度感應技術和閉環控制原理，元件的解焊、迴焊過程中，都經由非接觸式紅外線感應器監測 PCB 板上元件溫度。中等波長的紅外線燈管加熱器，具有均勻和安全的加熱系統所需求的功率和靈活性，對於 PCB 需求大熱量及其它無鉛拆焊高溫要求，都可輕易完成 BGA 元件的解焊、迴焊。



● IRsoft 溫度操作軟體

主機視窗加熱系統設有 10 組工作參數模式，可編輯溫度、時間控制，針對每一種模式都可進行參數修改。IR 的具體控制及 BGA 元件拆焊參數的設定，由皆由主機按鍵進行操作及控制。也可通過電腦 IRSoft 軟體連線，進行溫度及時間的參數設定和修改參數設定值，在電腦中可以儲存 100 組以上資料於。通過 IRsoft 溫度操作軟體，經由 PC 聯線，可以記錄、控制、分析 BGA 元件拆取、迴焊流程，並產生溫度曲線圖，滿足現代電子工業的嚴謹製程要求。整機操作簡單易學。

規格

型號	BGA900D
輸入電壓	AC220V/60Hz(單相 20A/ 需接地插)
總功率	3200W(max)
上部發熱器功率	120W×6=720W(IR 紅外線燈管 / 波長約 2~8 μ)
底部發熱器功率	400W×6=2400W(IR 外線燈管)
上部發熱器尺寸	20mm~60mm(X-Y 方向為可移動式視窗)
拆焊 BGA 零件尺寸	2mm×2mm~60mm×60mm
承載 PCB 板最大尺寸	450×420 mm
底部紅外線燈管預熱面積	240×240 mm
LCD 顯示視窗	65.7×23.5(mm)/16*2 個字元
上下移動馬達	步進馬達
BGA 零件溫度感測器	非接觸式紅外線偵測 BGA 元件溫度
紅外線溫度感應器	0~300°C (測溫範圍)
通訊 IRSOFT 溫度軟體	執行標準 RS-232 通訊協議 (另選購 Win10-64 位元 PC 聯機)
尺寸	816(L)×608(W)×516(H)mm
重量	約 36Kg